

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

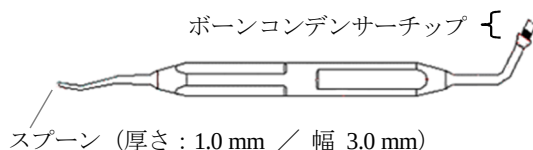
スプーン・ボーンコンデンサー

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本体の片方がスプーン状、もう一方はネジ式で、ボーンコンデンサーチップ（販売名：デプスゲージ・ボーンコンデンサー 届出番号：27B1X00109000238）を装着する。ボーンコンデンサーチップは、形成窩サイズに合わせて装着し、使用する。

全長：166.2 mm



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者：株式会社モリタ

電話番号：06-6380-2525

外国製造業者：チュソンテクノ CHEONGSONG TECHNO

国名：大韓民国

【お問い合わせ先】

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター

電話番号：0800-222-8020 (無料)

Fax 番号：0800-222-6480 (無料)

E-mail：e-customer@morita.com

【体に接触する部分の主な組成】

ステンレス鋼

【原理】

本体のスプーン状部分で骨補填材等を欠損部に移送・填入し、もう一方のネジ式部分にボーンコンデンサーチップ装着し、骨補填材等の充填、凝縮を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、インプラント手術に用いる。

本体のスプーン状部分は、骨補填材等を欠損部に移送・充填に使用し、もう一方のネジ式部分には、ボーンコンデンサーチップ（別売品）を装着して、骨充填材等の充填等に使用する。

【使用方法等】*

【使用方法】

スプーン状の作業部を使用する場合

- (1) 本体を手指で把持し、スプーン状の部分で骨補填材等を欠損部に移送・填入する。

ボーンコンデンサーチップ（別売品）を使用する場合

- (1) 本体に形成窩サイズに合ったボーンコンデンサーチップを装着する。
- (2) 本体を手指で把持し、骨補填材等の充填、凝縮を行う。

【組み合わせて使用する医療機器】

本品は、「販売名：デプスゲージ・ボーンコンデンサー（届出番号：27B1X00109000238）」と組み合わせて使用する。

【保守・点検に係る事項】

【滅菌】

- (1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：
115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
- (2) 136℃以上に加熱しないこと。